

Title (en)

Lead-containing additives for steel melts.

Title (de)

Bleihaltiges Zusatzmittel für Stahlschmelzen.

Title (fr)

Additif contenant du plomb pour des bains d'acier.

Publication

**EP 0316921 A1 19890524 (DE)**

Application

**EP 88119149 A 19881117**

Priority

DE 3739154 A 19871119

Abstract (en)

A lead-containing additive for molten steels is in the form of a filled wire consisting of a metallic shell and fine particles of a filling material, which consists of a) metallic lead and/or lead alloys and b) a lime-containing material which releases CO<sub>2</sub> at the temperature of the molten steel. <??>This additive allows reliable, controlled and uniform introduction of lead into the steel.

Abstract (de)

Es wird ein bleihaltiges Zusatzmittel für Stahlschmelzen beschrieben, welches in Form eines gefüllten Drahtes, bestehend aus einem metallischen Mantel und feinteiligem Füllmaterial vorliegt, wobei das feinteilige Füllmaterial aus a) metallischem Blei und/oder Bleilegienungen sowie, b) einem bei der Temperatur der Stahlschmelze CO<sub>2</sub>-abspaltenden kalkhaltigen Material besteht. Dieses Zusatzmittel ermöglicht ein sicheres und gezieltes sowie gleichmäßiges Einbringen des Bleis in den Stahl.

IPC 1-7

**C21C 7/00**; **C22C 33/00**; **C22C 38/60**

IPC 8 full level

**C21C 7/00** (2006.01); **C21C 7/04** (2006.01); **C22C 33/00** (2006.01); **C22C 38/60** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C21C 7/0056** (2013.01 - EP US); **C22C 33/00** (2013.01 - EP US); **C21C 2007/0012** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [Y] FR 2068264 A5 19710820 - NIPPON KOKAN KK
- [A] FR 2085306 A1 19711224 - LOIRE ATEL FORGES
- [A] DE 829802 C 19520128 - ALOYS WUESTEFELD DR
- [Y] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 9, Nr. 1 (C-259)[1724], 5. Januar 1985; & JP-A-59 157 215 (SHIN NIPPON SEITETSU K.K.) 06-09-1984

Cited by

FR2917096A1; DE10236354A1; DE10236354B4; WO2008152328A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0316921 A1 19890524**; **EP 0316921 B1 19930512**; AT E89325 T1 19930515; BR 8806056 A 19890808; DE 3739154 A1 19890601; DE 3880972 D1 19930617; JP 2760817 B2 19980604; JP H01162716 A 19890627; US 4892580 A 19900109

DOCDB simple family (application)

**EP 88119149 A 19881117**; AT 88119149 T 19881117; BR 8806056 A 19881118; DE 3739154 A 19871119; DE 3880972 T 19881117; JP 29033788 A 19881118; US 27053588 A 19881114